香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION
合肥晶合集成電路股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2249)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列合肥晶合集成電路股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
Nexchip Semiconductor Corporation
合肥晶合集成電路股份有限公司
執行董事兼董事長
蔡國智先生

香港，2026年11月26日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、邱文生先生、郭兆志先生及楊國慶女士；及(iii)獨立非執行董事盛明泉教授、蘭智挺教授及陳鋌先生。

证券代码：688249　　证券简称：晶合集成　　公告编号：2026-059

合肥晶合集成电路股份有限公司
关于以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份达到 3%暨回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次回购方案实施进展情况

回购方案首次披露日	2026/11/6，由董事长蔡国智先生提议
回购方案实施期限	2026 年 11 月 6 日~2027 年 11 月 5 日
预计回购金额	5 亿元~8 亿元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	9,043,491 股
累计已回购股数占总股本比例	0.40%
累计已回购金额	242,455,925.70 元
实际回购价格区间	25.84 元/股~28.62 元/股

- 前次回购方案实施完成情况

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十三次会议并于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司自 2024 年 4 月 8 日至 2025 年 3 月 5 日期间累计回购公司股份 62,088,500 股，回购成交的最高价为 15.31 元/股，回购最低价为 12.97 元/股，支付的资金总额为人民币 891,677,308.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），前述回购方案已实施完成。

截至 2026 年 11 月 25 日，公司通过上述两轮回购 A 股股份方案已累计回购公司股份合计 71,131,991 股，占公司当前总股本的 3.18%，累计支付的资金总额为人

民币 1,134,133,234.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、 本次回购股份的基本情况

公司于 2026 年 11 月 5 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份将在未来适宜时机用于 A 股员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 8 亿元（含）。回购价格不超过人民币 37.00 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购 A 股股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的公告暨回购报告书》（2026-049）。

二、 回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司股份回购进展情况公告如下：

（一）前次回购方案实施完成情况

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十三次会议并于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司自 2024 年 4 月 8 日至 2025 年 3 月 5 日期间累计回购公司股份 62,088,500 股，回购成交的最高价为 15.31 元/股，回购最低价为 12.97 元/股，支付的资金总额为人民币 891,677,308.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），前述回购方案已实施完成。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-011）。

（二）本次回购方案实施进展情况

2026 年 11 月 20 日至 2026 年 11 月 25 日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,043,491 股，占公司当前总股本的

0.40%，回购成交的最高价为 28.62 元/股，最低价为 25.84 元/股，支付的资金总额为人民币 242,455,925.70 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

综上所述，截至 2026 年 11 月 25 日，公司通过上述两轮回购 A 股股份方案已累计回购公司股份合计 71,131,991 股，占公司当前总股本的 3.18%，累计支付的资金总额为人民币 1,134,133,234.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

三、 其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日